

Porta-Wafer De Ptfе De 6 Polegadas Para Limpeza Por Gravura Úmida, Resistente A Ácidos E Alcalis, Transportador De Wafer De Fluoropolímero

Número do item: PL-CP421



introdução

Portas-wafer de limpeza de PTFE de 6 polegadas de alta pureza, projetadas para processos agressivos de gravura úmida. Esses transportadores de fluoropolímero resistentes a ácidos oferecem estabilidade química excepcional e contaminação ultrabaixa para fabricação de semicondutores e aplicações exigentes de análise de traços em laboratório e processamento químico.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Gravura Úmida de Semicondutores	Processamento de wafers de silício em banhos de HF, BOE ou ácido fosfórico quente.	Evita contaminação metálica e sobrevive a químicas agressivas.
Fabricação de Células Solares	Limpeza e texturização de substratos de silício para produção de células fotovoltaicas.	Durabilidade de alto volume e resistência a soluções de texturização cáusticas.
Análise de Metais Traço	Limpeza de vidraria de laboratório e substratos antes da análise ICP-MS.	Níveis de fundo ultrabaixos e zero lixiviação de íons para dados precisos.
Fabricação de MEMS	Manuseio de sistemas microeletromecânicos durante gravura por íons reativa profunda ou liberação úmida.	Manuseio delicado com alta precisão dimensional para estruturas frágeis.
Deposição Química em Fase Vapor	Pré-limpeza de substratos para garantir o crescimento de filmes finos de alta qualidade.	Garante uma superfície atômica limpa, resistindo a ácidos de pré-tratamento.
Limpeza Farmacêutica	Esterilização e limpeza de componentes de alta pureza em P&D farmacêutico.	Material compatível com FDA e com excelente resistência a agentes de esterilização.
Processos de Eletrodeposição	Segura substratos durante a deposição precisa de metal em banhos ácidos ou alcalinos.	Isolamento elétrico e resistência completa a eletrólitos de deposição.

Categoria de Especificação	Detalhes para PL-CP421
Número do Modelo	PL-CP421
Material Base	PTFE Virgem de Alta Pureza (PFA/TFM disponível sob solicitação)
Diâmetro Principal do Wafer	6 Polegadas (150mm) padrão
Capacidade do Wafer	Totalmente Personalizável (ex: 25 fendas, 50 fendas ou contagens personalizadas)
Largura/Passo da Fenda	Personalizável de acordo com a espessura do substrato e requisitos de espaçamento
Design da Alça	Fixa, Destacável ou Estendida (Personalizada para profundidade do banho)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Categoria de Especificação	Detalhes para PL-CP421	
Resistência à Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)	
Método de Fabricação	Usinagem CNC de Precisão de 5 Eixos	
Acabamento Superficial	Ra < 0,8µm (Típico) ou polimento personalizado	
Compatibilidade Química	Universal (Exceto para metais alcalinos fundidos e flúor elementar)	
Conformidade	Grau Semicondutor / Grau de Análise de Traços	